

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2026-023

北京屹唐半导体科技股份有限公司

关于投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司屹唐半导体科技（北京）有限责任公司（以下简称“屹唐北京”）在北京经济技术开发区投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目（以下简称“本项目”），聚焦干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理等设备规模化生产。

● **投资金额：**本项目投资总额约为人民币 18 亿元。

● **已履行的审议程序：**本事项已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议、第二届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易和重大资产重组。

● **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：**

1、本项目所涉及的项目用地尚需按照国家法律法规的规定通过招拍挂程序取得。本项目投资、实施是以屹唐北京竞得项目土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

2、本项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，本项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、随着市场参与者增加、同行业公司扩大产能以及新技术、新产品替代的出现，半导体设备市场竞争将进一步加剧，可能影响销售目标的实现。

4、本项目建设及运营过程中面临施工进度延迟、关键设备采购交付延期等多重挑战，可能导致达产推迟、成本上升、财务收益不及预期。

5、本次投资系公司基于长期战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做出的决定，由于本项目实施周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，可能存在投资计划及收益不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步拓宽公司业务布局，把握市场发展机遇，公司拟通过全资子公司屹唐北京在北京经济技术开发区投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目，并与北京经济技术开发区管理委员会签订相关合作协议。

本项目主要进行干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理等设备规模化生产，项目投资总额约为人民币 18 亿元，包含土地出让金、厂房建设及设备购置等费用，最终以实际投资额为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	屹唐半导体集成电路装备制造基地项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>约人民币 18 亿元</u> ☐ 尚未确定

出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☒ 其他：其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

本事项已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议、第二届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目具体情况

公司拟通过全资子公司屹唐北京在北京经济技术开发区投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目，项目投资总额约为人民币 18 亿元。项目主要聚焦半导体设备制造与未来产业发展方向，实现公司自主研发的干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理等设备规模化生产。公司拟通过公开竞拍方式取得土地使用权，推进上述项目建设，以满足公司业务发展和产能升级需求。

本项目拟选址于北京市北京经济技术开发区，具体以屹唐北京与北京经济技术开发区管理委员会签署的协议为准。

（二）投资项目可行性分析

1、公司深耕集成电路设备领域，具备自主研发能力，知识产权积累深厚，客户资源优质稳定，产品具备国际竞争力，为本项目实施奠定坚实基础。

2、本项目实施将全面提升公司产品的量产能力与交付效率，更好地满足市场及客户需求，推进公司长期发展战略目标的实现。

3、本项目聚焦干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理等半导体设备生产，符合国家集成电路产业政策，有助于推动半导体设备产业高质量发展。

4、本项目将配套建设生产及辅助生产、动力、环保、安全等设施，与半导体设备规模化生产和工艺需求相匹配，保障本项目顺利实施。

5、本项目具有良好的预期经济效益，能够提升公司盈利水平，同时带动当地社会就业、提升劳动力素质，促进产业集聚，具有显著的产业带动效应和社会效益。

（三）出资方式及相关情况

本项目不涉及其他投资方，公司全资子公司屹唐北京为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式建设本项目。投入资金将用于本项目用地购置、厂房建设及设备购置等。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资聚焦公司产能扩张建设，有利于公司进一步拓宽业务布局，扩大产能规模，增强综合竞争优势，提升可持续盈利能力，符合公司长期发展战略规划，对公司持续高质量发展具有重要且积极的影响。

截至本公告披露日，公司财务状况良好，能够满足本项目在项目建设期及运营期的资金需求。对本项目的建设投资不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

四、对外投资的风险提示

（一）本项目所涉及的项目用地尚需按照国家法律法规的规定通过招拍挂程序取得。本项目投资、实施是以屹唐北京竞得项目土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

（二）本项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，本项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）随着市场参与者增加、同行业企业扩大产能以及新技术、新产品替代的出现，半导体设备市场竞争将进一步加剧，可能影响销售目标的实现。

（四）本项目建设及运营过程中面临施工进度延迟、关键设备采购交付延期

等多重挑战，可能导致达产推迟、成本上升、财务收益不及预期。

（五）本次投资系公司基于长期战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做出的决定，由于本项目实施周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，可能存在投资计划及收益不达预期的风险。

公司将利用自身积累的技术及产业经验与管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，降低潜在风险。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日